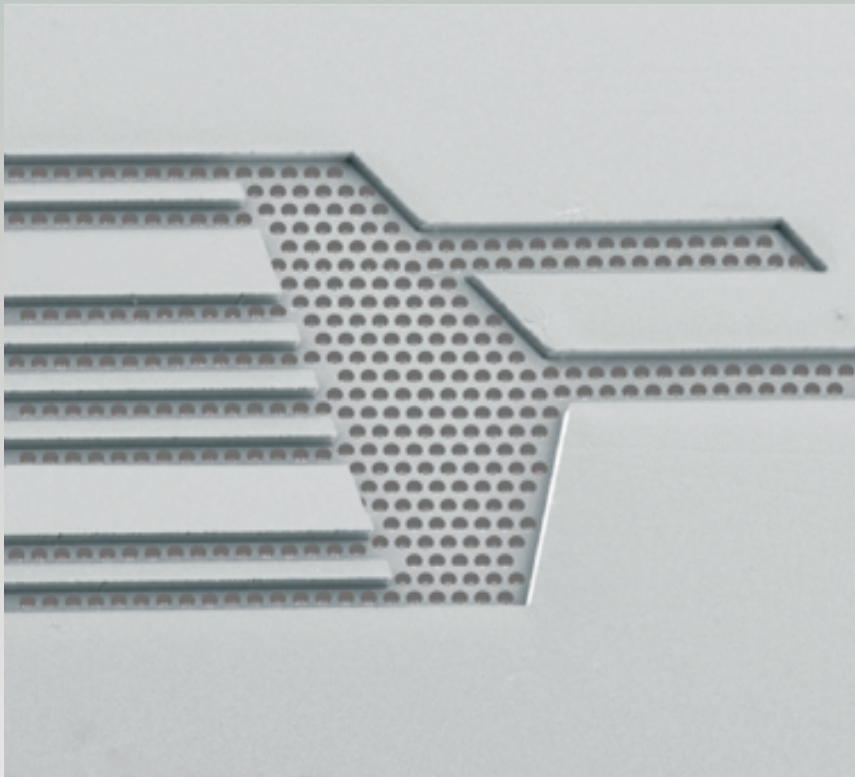


CADiLAC Laser



- Revolutionäre Drucktechnologie
- Mikrostrukturen für Elektrotechnik & Fluidik
- Höchste Abbildungsschärfe feinsten Strukturen
- Kombination aus Sieb- und Schablonentechnik
- Hohe Standzeit

SDS StrukturDruckSchablone



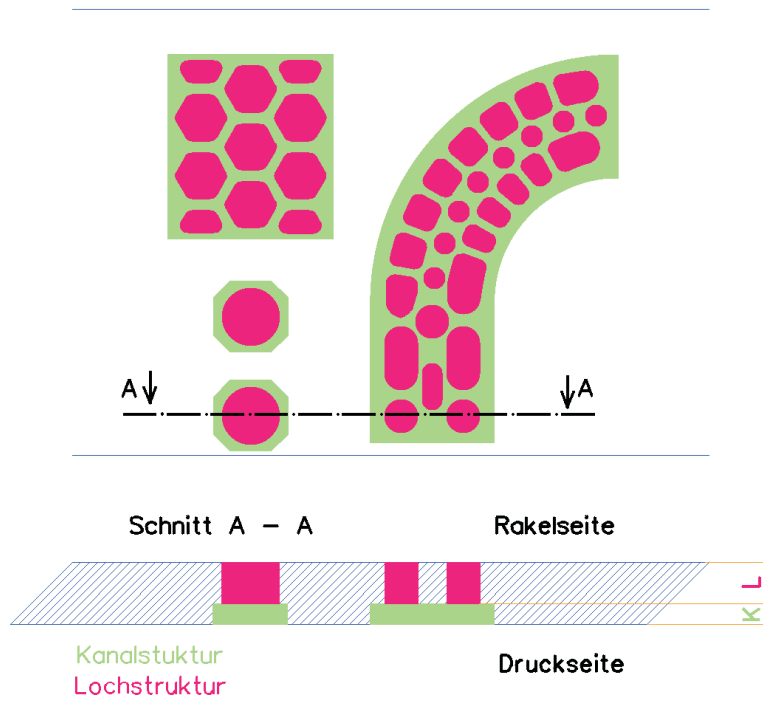
Die StrukturDruckSchablone SDS ersetzt die traditionelle Siebtechnik in Bereichen von 2-fach Prozessen wie Siebdruck + Viafilling. Sie verbindet das Sieb mit der Viafill-Schablone in einer einzigen Schablone. Dadurch werden 2 Prozess-Schritte auf einen Prozess reduziert. Leiterbahnen und Vias werden in einem Durchgang gedruckt.

Mit der SDS können Feinststrukturen realisiert werden, welche mit der klassischen Siebtechnik nicht mehr möglich sind wie z.B. Strukturen von 10-20µm.

Es wird eine präzisere Konturschärfe und ein verbesserter Pastenauftrag erreicht.

Materialbedingt ist mit der SDS eine wesentlich höhere Standzeit gegenüber Sieben zu erwarten.

Mitgeltendes Schutzrecht
DE 20 2005 007 549.



SDS StrukturDruckSchablone

Technische Parameter	
Kanalschichttiefe K	ab 15µm in 5µm Schritten
Lochschichttiefe L	ab 15µm in 5µm Schritten
Kanalbreite	min 20µm
kleinster Abstand zwischen Kanälen	Kanaltiefe
kleinster Lochdurchmesser	Lochtiefe/3 + 10µm
kleinster Abstand zwischen Löchern	Lochtiefe/2 + 5µm
geometrische Struktureinschränkungen	keine
Genauigkeit der Ausrichtung von Kanal- zu Lochschicht (alignment)	min +/-2µm*
Toleranzen Kanaltiefe	min +/-2µm*
Toleranzen Kanalbreite	min +/-2µm*
Toleranzen Lochdurchmesser (Lochseite)	min +/-2µm*

* Toleranzen in Abhängigkeit von der Materialdicke

Lieferzeit	auf Anfrage, projektabhängig
-------------------	------------------------------

Erstausgabe 20.07.2009, Stand 16.01.2013, Änderungen vorbehalten

CADiLAC Laser



CADiLAC Laser GmbH
Boschring 2
D-91161 Hilpoltstein
Tel. +49 9174 4720-0
Fax +49 9174 4720-50
www.cadilac-laser.de
info@cadilac-laser.de

